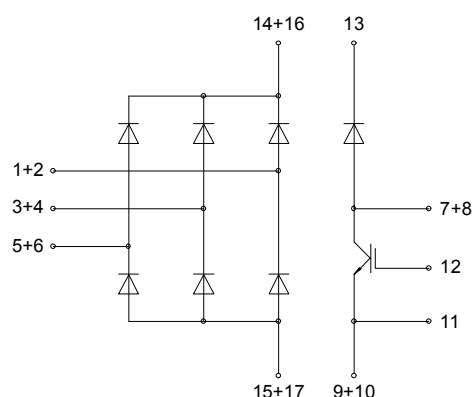
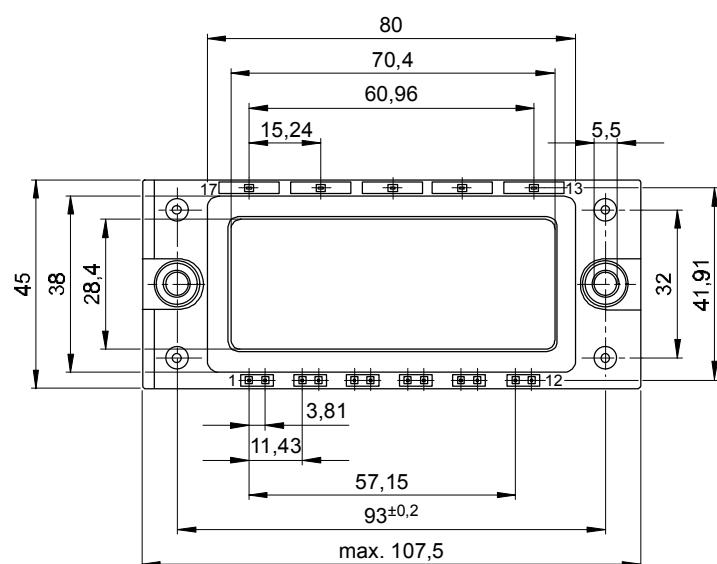
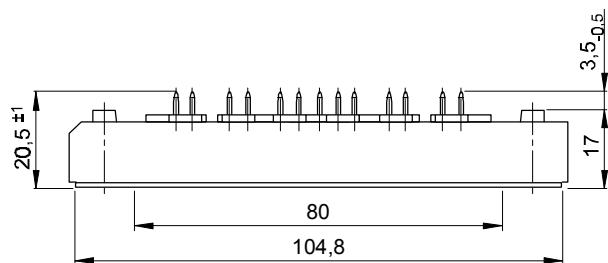


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company

Marketing Information DD B6U 100 N 12...16 RR



Technische Information / Technical Information

euppec

Dioden-Mosai mit Copper-
IGBT

DD B6U 100 N 12...16 RR

Vorläufige Daten
Preliminary data

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Netz-Diode / Rectifier diode					
Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots T_{vj\max}$	V_{RRM}	1200, 1400 ###	V	
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) RMS forward current (per chip)		I_{FRMSM}	60	A	
Ausgangsstrom output current	$T_C = 100^\circ\text{C}$ $T_C = 97^\circ\text{C}$	I_d	100 104	A A	
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\max}, t_p = 10\text{ms}$	I_{FSM}	650 550	A A	
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\max}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	2100 1500	A^2s A^2s	
IGBT					
Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V	
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current		I_C	50	A	
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{CRM}	100	A	
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	350	W	
Gate-Emitter Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GE}	± 20	V	
Schnelle Diode / Fast diode					
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	25	A	
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	50	A	
Modul					
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}$, $t = 1\text{min}$	V_{ISOL}	2,5	kV	

Charakteristische Werte / Characteristic values

Netz-Diode / Rectifier diode			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}, I_F = 100\text{A}$	V_F			1,55	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}$	$V_{(TO)}$			0,75	V
Ersatzwiderstand forward slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\max}$	r_T			5,5	$\text{m}\Omega$
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\max}, V_R = V_{RRM}$	i_R			5	mA
IGBT						
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 50\text{A}, V_{GE} = 20\text{V}$ $T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_C = 50\text{A}, V_{GE} = 20\text{V}$	$V_{CE\text{ sat}}$		2,5 3,1	3,2	V
Gate-Emitter-Schwelspannung gate-emitter threshold voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 2\text{mA}, V_{GE} = V_{CE}$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V

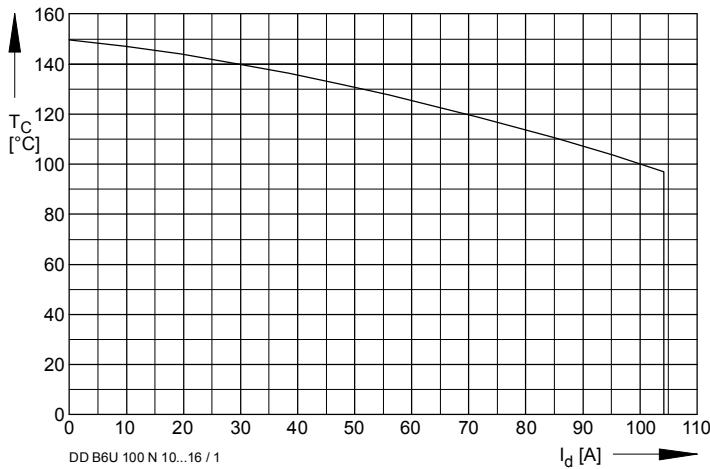


Bild / Fig. 1

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $T_C = f(I_d)$

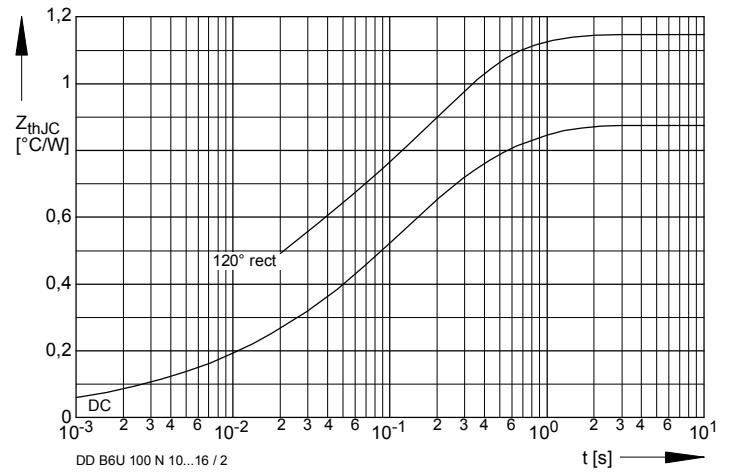


Bild / Fig. 2

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm
 $Z_{thJC} = f(t)$
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
 Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4
R_{thn} [°C/W]	0,47800	0,28200	0,05300	0,06500
τ_n [s]	0,30200	0,03780	0,00400	0,00109

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}}\right)$$